



行业动态  
Industry News

### 清华大学与TSMC携手提供晶圆共乘服务

2010-01-04 | 编辑: | 【大】 【中】 【小】 【打印】 【关闭】



国家863计划信息领域专家组成员暨清华大学教授王志华(右)与TSMC中国业务发展副总经理罗镇球(左)代表清华大学与TSMC完成签约仪式。



从左往右: TSMC中国业务发展总监陈文俊; 北京海尔集成电路设计有限公司常务副总经理阳艳春; TSMC中国业务发展副总经理罗镇球; 清华大学副校长陈旭; 国家863计划信息领域专家组成员暨清华大学教授王志华; 清华大学微电子

- ▣ 科普首页
- ▣ 微电子历史
- ▣ 行业动态
- ▣ 术语解释
- ▣ 无微不至
- ▣ 芯片制程
- ▣ 科普创意



清华大学与TSMC 23日宣布，将共同邀请在半导体领域表现杰出的清华大学校友，在2010年举办一系列半导体创新人才演讲及座谈会，同时TSMC将提供清华大学最先进的65nm及90nm工艺晶圆共乘服务，丰富优秀的青年学子在集成电路设计领域的实务经验，协助中国的集成电路设计业向下扎根，为TSMC在中国的大学晶圆共乘项目揭开序幕。

近百年来，清华大学为中国各行各业培育出无数的优秀人才，尤其在半导体领域，许多占有一席之地的重要领导人物多为其杰出校友。清华大学与TSMC为学界及产业界搭起双向沟通的桥梁，每季将邀请两位业界领袖返校和学弟妹分享全球及中国半导体业的发展趋势、前瞻技术概况、当前市场竞争形势及个人的创业历程，写下承先启后的美好传承，并将同时对学校的研究项目提出产业界的建议。首场专题演讲将由同为1993年毕业的清华校友—北京海尔集成电路设计有限公司常务副总经理阳艳春先生及北京昆腾微电子有限公司首席执行官向毅海先生担任主讲人。

国家863计划信息领域专家组成员暨清华大学教授王志华博士表示，藉由TSMC的支持，清华的学子不仅能利用TSMC卓越的先进工艺进行系统芯片的创新设计，并能与中国半导体业深具影响力的领袖人物面对面沟通。在半导体体的学习道路上，这些已在业界头角峥嵘的学长化身良师，为后进指引明路，让学子们除了奠定扎实的学理基础外，更能在走出校门前，了解半导体体的实际运作，掌握创新与创业的精髓，在未来成为富有创新思维的领导人才。

TSMC中国业务发展副总经理罗镇球指出，人才是中国半导体业发展的动能，我们希望藉由产学的密切合作，结合实务与学理，孵化人才的创新力量，支持中国半导体体的成长。尤其，中国的集成电路设计业早已汇聚许多深具影响力的领导人才，我们希望为学子创造亲近业界领袖的机会，激荡出产学交流的火花，培育新一代的半导体业生力军。

#### 清华大学/TSMC晶圆共乘项目

TSMC为了协助清华大学优秀的青年学子实现其卓越的设计构想，自2010年起将提供最先进的65nm及90nm工艺晶圆共乘服务，让他们在TSMC的协助下，落实系统单芯片（SOC）的数字、模拟、射频混合信号集成电路设计以及IP核的创新开发。目前清华大学已经启动的前沿研究项目包括应用于便携设备、音视频与汽车防撞雷达的高速高精度数模转换芯片；应用于3G手机射频收发器的锁相环电路；宽频通信网的多模射频前端芯片以及超高分辨率雷达成像芯片。

#### 主讲人背景资料

阳艳春先生深耕集成电路设计领域，2000年加入北京海尔集成电路设计有限公司，主管设计流程和集成电路开发，在2001年成功推出中国第一枚拥有自主知识产权并产业化的数字电视解码芯片，目前担任常务副总经理，负责公司的营运大任。

向毅海先生曾服务于Conexant、Mindspeed及Intel等世界知名半导体公司，拥有丰富的模拟射频及数字信号处理设计经验、多项美国发明专利并荣获两项英特尔设计成就奖，数年前创立昆腾微电子，在集成电路研发、生产与管理方面的经历傲人。

（来源：半导体国际 2008年12月24日）



中国科学院微电子研究所版权所有 邮编：100029

单位地址：北京市朝阳区北土城西路3号，电子邮件：webadmin@ime.ac.cn

京公网安备110402500036号